А.Д. Мурадов, А.М. Есенгазиев, Г.С. Суюндыкова

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті г.Алматы, Казахстан

ҚАБЫҚША ТНЗУШІ ҚАБАТ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ АЛЫНҒАН ПОЛИИМИДТІҢ ФОТОСЕЗІМТАЛ ҚІЬРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ

Анотация. Бұл жұмыс жұқа аморфты күміс қабықшаларының бетін эксперименталды зерттелінуіне сүйенген. Күміс қабықшасының топографиялық бейнесі кедір-бұдырлы рельефпен сипатталады. Жалпы айтқанда бет морфологиясы кластерлік құрылымды кәрсетеді. Кластердің кәрінетін мәлшері қабықшаның қалыңдығымен сәйкес, кластердің беттік шегі байқалмаған, формасы изометриялық емес, домалақ пішіндес. Дегенмен тығыз жинақталуына байланысты кәп жағдайларда полиэдрлік формаға ие. Күміс қабықшалардың кластерлері бір-бірінен анық ажыратылады және кластерлердің статикалық әлшемдері бір-бірінен алшақ емес. Қабықша металдануының барлық үш типіне сәйкес, сәулелендіру дозасының әсуі, электр кедергісінің де айтарлықтай әсуіне алып келетінің кәрсетті.

Титин сәздер: қабықша, аморфты күміс, ұнтақ, нанобәлшектер, морфология, электр кедергісі.

Кіріспе

Микрожәне оптоэлектроникада, оптикада сонымен қатар техниканың әзге де салаларындағы қарқынды даму үдерісі, жұқа кабықшалық технологияның дамуымен тікелей байланысты [1-4]. Қазіргі таңдағы ғылым мен техниканың даму деңгейі қабықша сапасының жоғары болуына, касиеттерінің олардың рационалды қолданылуы жоғары талаптар қояды [2-4]. Зерттелінетін объектінің сапасын анықтауда ерекшеліктер, меншікті құрылымдық эткізгіштік, беттің сапасы және уақыт ұзақтығына байланысты зат қасиеттерінің тұрақтылығы маңыздылыққа ие [1-7].

Нанотехнологияның кёз алдымызда қарқынды түрде дамуы қалыңдығы небәрі ондаған нанометрді құрайтын касиеттерін зерттеуге кабыкшалардың жетелейді. Сонымен бірге соңғы кездері заттардың аморфты күйі де кәп зертеліну устінде [1-7]. Айта кетсек, аморфты қабықшалардың параметрлері, электрлік оның ішінде меншікті әткізгіштік. Әдетте аморфты қабықшалардың меншікті эткізгіштігі кристалдық күйінен бірнеше есеге тәмен, әйткені дефекттерден шағылу есебінен аморфты қабықшаларда еркін электрондар концентрациясы мен электронның еркін жүру жолы тәмен [8,11,12]. денгейде болады Дегенмен қабықшаның электродинамикалық қасиетін

анықтайтын негізгі параметр осы меншікті әткізгіштік болып табылады.

Казіргі қабықшалар таңда жұқа эндірістің кәптеген аймағында, мысалға оптикалык приборларда (кәпқабатты интерференционды жүйелер), микроэлектроникада (пассивті және активті элементтер), авиакосмостық құрылғылар серіктердің құрастыруда (жер температурасын реттестірудегі беттік кабықшалар) кеңінен қолданылуда [2,4,7].

Бұл жұмыс жұқа аморфты металдық (күміс, Ag) қабықшалардың бетін эксперименталды зерттелінуіне сүйенген. Сонымен қосақұрылымдық және әткізгіштік ерекшеліктерге сәйкес, байқалынатын заңдылықтарға орай байланысты анықтауға негізделген.

Зерттелінетін қабықшалар сипаттамасы

Бұл жұмыста химиялық отырғызу әдісі диэлектрлік полимер арқылы тәсенішкекүміс қабықшалары бӛлме температурасында алынып, зерттелінген. Араластырушы құрылғысы, кері тоңазытқышы мен инертті газды беруші капилляры бар үш ауызды колбаға 2,0 г (0,01 моль) ОДА және 2,74 г (0,01моль) АБ 12 мл м-крезол ендірдік. Реакционлы қосындыны араластыру температураны баяу 170⁰С дейін кәтеріп, 5 сағат уақыт кәлемінде жүргізілді.

Реакционды ерітіндінің концентрациясын 7% тәмендетіп, оны шыны тәсеніш бетіне құйып, 200^{0} С кептіргеннен соң, ол шыны бетінен қабықша күйінде алынды. Ұнтақ тәріздес үлгілерді алу үшін полимерді ацетон негізіндегі ерітіндіден отырғызып, 100^{0} С кептірілген болатын.

Биниклооктенжәне трициклодецентетра-карбондык кышкылы негізіндегі полиимидтер ДМАА-да бір поликонденсация стадиялық арқылы каталитикалык мәлшері бар триэтиламин қатысында алынған. Полимер құрамындағы полиимид (ПИ) мёлшері 1-ден 5 масс. % кёлемінде. Циклогексанон (инертті еріткіш) 40-60 масс.% мәлшерінде енгізілген. Циклогексанонда акрилаты бар полиимид ерітіндісіне 0,1 масс % инициатор ДАК косылды. Полимеризация бӛлме температурасынан бастап баяу 100⁰С дейін кәтеру арқылы жүзеге асырылды. Алынған полимерді этанолға отырғызып, спиртте оны жуып және вакуумда кептіргіш шкафта бёлме температурасында тұрақты салмағына келгенше кептіруді жүзеге асырдық.

Қондырғылар және тәжірибе әдістемесі

Беттің морфологиясы. Қабықша бетінің морфологиясын зерттеу Атомдық – күштік микроскоп (АКМ) Ntegra Therma (Nt –MDT) арқылы максималды сканерлеу аумағымен 5×5µm жүзеге асты. Зонд ретінде пирамида пішіндес ұшының бұралу бұрышы ~10nm және қаттылғы 22N/m стандартты кремнийлік кантилеверлер (Burleigh)

колданылды. АКМ латеральды

Зерттеудің негізгі нәтижесі және оны талқылау

Қалыңдығы 63 nm болатын күміс қабықшасының сипаттамалы беті 1 суретте кәрсетілген. Суретте қарап отырғаңымыздай кабыкшасының топографиялык куміс бейнесі кедір-бұдырлы рельефпен сипатталады. Жалпылама айтканда бет морфологиясы кластерлік (блоктык) құрылымды кәрсетеді. Кластердің кәрінетін мәлшері қабықшаның қалыңдығымен сәйкес, кластердің беттік шегі байқалмаған, формасы изометриялык емес, домалак пішіндес. Дегенмен кабыкшаның

ажыратылымдықта қатты дене бетінің үшәлшемді топографиялық бейнесін алуға мүмкіндік береді. Үлгінің беттік бейнелері бәлме температурасында алынды.

Keithley 6517В электрометрі жоғарғы жұмыс істеу жылдамдығына ие, дыббысыз (шудың деңгейі 0,75 фА) жұмыс жасайтын разрядтық мультиметр, әлшеу барысында аз мәнді токты (0,1 фА – тен), жоғары мәнді электр кедергіні, петадан эксаомға дейінгі (10¹⁶Ом-ке дейін), жоғары импедансты тоқ кәзін. зарядты, температураны, ылғалдылықты кәрсете алады, сонымен бірге ±1 κВ *ёзіндік* ток к*ёзімен* құрылғы қамтамасыз етілген. Құрылғы кәмегімен алынған жұқа қабықшалардың кедергісі Кабықша электр кедергісінің **э**лшенлі. белгілі болуы меншікті әткізгіштікті әлшеуге мүмкіндік берді.



Сурет 1.– Атомдық күштік микроскоп кәмегімен алынған күміс қабықшасының беті

кластерлері тығыз жинақталғандықтан, кöп жағдайларда полиэдрлік формада да түзіледі. Күміс қабықшалардың кластерлік құрылымы анық кöрiнедi, кластерлер бiрбiрiнен анық ажыратылады және кластерлердiң статикалық öлшемдерi бiрбiрiнен алшақ емес.

Жҧмыстың негізгі нәтижелері

1. Полимерлі тәсенішке химиялык отырғызу әлісі арқылы бӛлме температурасында қалыңдығы 63 nm болатын, кластерлік құрылымға ие, аморфты күміс қабықшасы отырғызылған. Меншікті *әткізгіштіктін* кабыкша қалыңдығына,

Тёмен қалыңдықта (қабықша әлі түзілмей тұрғандағы 40 nm дейінгі қалыңдықта) бұл тәуелділік айтарлыктай байкалмайды. Салыстырмалы алғандаулкен кәлемлі кристалдық материалдарға қарағанда, мұнда тіркелген әткізгіштіктің тәмен кәрсеткішіне талдау жасалынған. Яғни қабықшаның тәмен калындығы және оның кластерлік құрылымы қабықшаның қалыңдығы 40 nm тәмен жағдайда тіркелген мәліметке түсініктеме бола алады, және үлкен мәнді қалыңдықта бұл механизм іске аспайды. Кұрылымның аморфты сипаты қабықша әткізгіштігінің аз мәнін түсіндіре алады, бірақ бұл құбылыс механизмі толық зертеуді қажет етеді.

2. Қоспалы материалдың морфологиясы біртекті полиимидті матрицадан және онда біріңғай таралған әлшемі 1-50 мкм болатын дисперсті фаза күміс бәлшектерінен құралған. Дара полимер негізіндегі қоспа гомогенді екені байқалады, және соған сәйкес қабықша – мәлдір.

3. Металлополимерлік қабықшалардың электрлік касиеттерді зерттелінген. Алынған нәтижелер улгі металдануының барлық үш типіне сәйкес, сәулелендіру дозасының әсуі D электр кедергісінің айтарлықтай әсуіне алып келетінін кёрсетеді. Сонымен катар

металдану дәрежесі де электр кедергісінің әсуіне әз ықпалын тигізеді.

Список литературы

 Абелес Ф. // Физика тонких пленок. Т. 6. - М.: Мир, 1973. - С. 171 - 227.
 2. Хасс Г. Физика тонких пленок.

Т. 1. - М.: Мир, 1967. - 343с.

3. Технология тонких пленок. Сб. статей / Под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга. Пер. с англ. М.И. Елинсона, Г.Г. Смолко.

М.: Сов. радио, 1977. - 662 с

4. Елинсон М.И. // РЭ. - 1968. № 1. - С. 3–30.

5. Соколов А.В. Оптические свойства металлов. - М.: Физмат- лит, 1961. - 464 с.

6. Суху Р. Магнитные тонкие пленки. - М.: Мир, - 1967. - 423 с.

7. Бек Г., Гюнтеродт Г.Й. Металлические стекла. М.: Мир, - 1983. -454 с.

8. Займан Дж. Модели беспорядка.- М.: Мир, - 1982. - 592 с.

9. Полухин В.А., Ватолин Н.А. Моделирование аморфных металлов.- М.: Наука, - 1985. - 288 с.

10. Андреенко А.С., Никитин С.А.
// УФН. – 1997, - Т. 167, - № 6.- С. 605.
11. Marchal G., Mangin P., Janot C.

// Thin Solid Films. – 197, - Vol. 23. P. 17. 12. Hasegava R. // Phys. Rev.

Lett. - 1972, - Vol. 28. - P. 1376.

13. Liu H.-D., Zhao Y.-P., Ramanath G. et al. // Thin Solid Films.

Приложение

Кесте 1. - Электр кедергісінің металданған полиимидті қабықшаның ұзындығына тәуелділігі. (d=30 мкм D= 0: N1 – тёмен N2 – орташа: N3 – жоғарғы металдану дәре

уелділігі.($0=30$ мкм, $D=0$: $N1 - тәмен N2 - орташа; N3 - жоғарғы металдану дәрежесі)$											
N1	R 1,	R2,	R з,	R4,	R 5,	R 6,	R 7,	R 8,	R 9,	R 10,	Rav,
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
L ₀ =60,	17.5	17	16	17.5	16.5	17	17	17.5	17.5	17.5	17,2
MM	30	30	30	30	29	28	29	30	30	30.5	29,8
L ₁ =50,	15	15	14	14	14	13.5	14.5	14	14	15.5	14,4
MM											
	23	23	27	20	25	21.5	26	27.5	23	27.5	24,4
L ₂ =40,	12.5	12	11.5	12	11.5	11	11.5	11	11.5	12.5	11,7
MM											
	19.5	19.5	23	18	17	18	22.5	23.5	19.5	23.5	20,4
L ₃ =30,	10	9.5	8.5	9.5	9	9	9.5	8	9	10	9,2
MM											
	11.5	11.5	20	9.5	19	10.5	19	20	11.5	20.5	15,3
L ₄ =20,	7.5	6.5	6	6.5	6.5	6	6.5	6.5	6.5	7.5	6,6

ММ											
	8	8.5	12.5	6.5	12	7.5	12	12.5	8.5	12.5	10,1
L ₅ =10,	4	4	3.5	4	3.5	3.5	4	3.5	3.5	4.5	3,8
ММ											
	4.5	4.5	8,5	4	8	4	8,5	9	4.5	9	6,5
N2											
L ₀ =60,	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12	12,5	12,5	12,5
MM	17	16,5	17	16,5	16	17	17,5	16,5	17	16,5	16,5
L ₁ =50,	10,5	10	11	10,5	11	10	11	10,5	11	10	10,6
MM											
	15,5	14,5	15	14	14	15	14,5	15,5	15	14	14,4
L ₂ =40,	9	7,5	9	8	9	8	9,5	8	9	8	8,5
MM											
	14	12	14	8,5	13	14,5	12	14	13	14	12,9
L3=30,	7	5,5	7,5	5,5	7,5	6	7,5	6	7,5	6	6,6
MM	40.5		40.5	0.5	0.5	10	0.5	40.5	4.4	10	
	12,5	6	12,5	6,5	6,5	12	6,5	12,5	11	12	9,8
L4=20,	5	4	5	4	5,5	4	5,5	4	5	4	4,6
MM		4	5	4 5	4	<i>E</i><i>E</i>	4 5	F F	6	C F	E 4
1 10	5,5	4	5	4,5	4	5,5	4,5	5,5	0	0,5	5,1
L5=10,	3	2	3,5	2	3,5	2	3,5	2	3	2	2,7
MM	35	2.5	3	2.5	2	2.5	3.5	35	3	2.5	20
N3	3,5	2,5	5	2,5	2	2,3	3,5	3,5	5	2,5	2,9
	15	15	15	15 5	15	15.5	15	15	15	15.5	15 1
L0=00,	15	15	15	15,5	15	15,5	15	15	15	13,5	13.1
MM	11	11.5	11	11	11	11 5	11	11 5	11	11 5	11 2
14-50	12	13	12	13	12.5	13.5	12	13	12.5	12	12.6
∟1–00, мм	12		12		12,0	10,0	12		12,0	12	12.0
IVIIVI	9.5	10	9.5	10	9.5	10.5	9.5	10	10.5	9	9.8
$1_{2}-40$	9	11	Q Q	11	10.5	11.5	9	11	10.5	9	10.2
∟2– т 0, ММ			5		10,0	11,0	5	1	10,0	5	10.2
	7	9	7.5	9	8	9.5	8.5	9	7.5	7.5	8.3
L3=30.	6.5	9	7	9	7.5	9.5	7	9	7.5	7	7.9
MM	-,-	-		-	- , -	-,-			- , -	-	
	6	7	6	7	6	6,5	6	7	6	7	6.5
L4=20,	4,5	7	4,5	7,5	5	8	4,5	7	5	4,5	5,8
MM											
	4,5	6,5	4,5	6,5	4,5	6	4,5	6,5	5	4,5	5,3
L ₅ =10,	2,5	4	2,5	4	4,5	4	2,5	4	4,5	2,5	3,5
MM											
	3	4	3	4	3	4	3	4,5	3,5	3	3,5

Журнал проблем эволюции открытых систем

Кесте 2. - Электр кедергісінің металданудың әр түрлі дәрежесіне сәйкес металданған полиимидті қабықшаның сәулелендіру дозасына тәуелділігі(мұнда, т=8400 с, D=14 МГр).

·	R1, Ом	R2, Ом	R3, Ом	R4, Ом	R5,Ом	R6,Ом	R7,Ом	R 8,Ом	R 9,Ом	R10,Ом	Rav,Oм
N1				<u> </u>	0.0						
L0=60,	32	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30,2
MM	∞ ⊃E	∞ 07 F	∞ 24	∞ ∞	∞ 07 F	∞ 24	∞ 24 F	∞	∞ or	∞ 07 F	∞ 25.0
L1=50,	25 69	27,5	24 65	25 69	27,5	24 65	24,5	28 67	25	27,5	25,8 66.6
MM	00 10 5	00 22 F	10	00 10 5	00 00 E	10	07	07	00	00 22 F	00,0
L2=40,	19,5	23,5	19	19,5	23,5	19	19	23	20	23,5	21
101101	11	50	<u>11</u>	ΔΔ	50	44	44	50	50	44	46.4
$1_{2}=30$	14	18	13.5	14	18	13.5	14	17.8	13.5	18	15.4
<u>–</u> 3–00, ММ		10	10,0	••		10,0		,0	10,0	10	10,1
	30	45	30	30	45	30	30	45	30	45	36
L4=20,	10	13	9	10	13	9	10,5	12,5	8,5	10	10,6
MM								-			
	24	38	23	24	38	23	23,5	37,5	22,5	24	27,8
L ₅ =10,	5,5	8,5	5	5,5	8,5	5	6	9	5,5	8,5	6,7
MM											
	18	24	17	18	24	17	18,5	24,5	18	24	20,3
N2	10		4.0		4.0		10	10		10	
$L_0 = 60,$	49	52	49	52	49	52	49	49	52	49	50,2
MM	∞ ∞	∞	∞ 40 E	∞ ∞	∞ 40	∞ 40 ⊑	∞ ∞	∞ 40	∞ 40 F	∞ ∞	∞
L ₁ =50,	23,5	48	16,5	23,5	48	16,5	23,5	48	16,5	23,5	28,8
MM											
1 - 10	∞ 17	∞ 40	∞ 17	∞ 17	∞ 40	∞ 17	∞ 40	∞ 17	xx 4.2	∞ 17	∞
L2=40, MM	17	42	17	17	42	17	42	17	42	17	21
	∞	∞	∞	∞	∞	x	∞	∞	x	∞	∞
L ₃ =30,	13,5	36	13	13,5	36	13	13,5	36	13	13,5	20,1
MM											·
	15	13,5	13	15	13,5	13	15	13,5	13	15	14
L4=20,	9,5	32	9	9,5	32	9	9,5	32	9	9,5	16,1
	9	10.5	10	9	10,5	10	9	10,5	10	9	9.8
L ₅ =10,	4.5	28	3.5	4,5	28	3.5	4.5	28	3.5	4.5	, 11.3
MM	,					,	,		,	,	
	4,5	6,5	6	4,5	6,5	6	5	7	6,5	4,5	5,7
N3											
L ₀ =60,	28	29	29	28	29	29	28	29	28	28	28,5
MM	19	19	19,5	19	19	19,5	19	19,5	19	19,5	19,2
L ₁ =50,	23,5	24,5	23,5	23,5	24,5	24	25	23,5	24,5	24,5	24,1
MM		10 -			10 -	4.0			10 -	1.0	10
	15	16,5	15,5	15	16,5	16	1/	15,5	16,5	16	16
L2=40, мм	15,5	21,5	16	15,5	21,5	16	16	22	16,5	21,5	18,2
	11,5	13,5	12,5	11,5	13,5	12,5	12	14	13	13,5	12,8
L3=30, мм	11,5	18	12	11,5	18	12	17,5	11,5	11	12	13,5
	9	12	9,5	9	12	9,5	11,5	9	8,5	9,5	10

Журнал проблем эволюции открытых систем

L4=20,	8,5	14,5	8,5	8	8,5	14,5	14	8,5	14,5	8,5	10,8
MM											
	6,5	9,5	6,5	6	6,5	9,5	9	6,5	9,5	6,5	7,6
L ₅ =10,	5	9,5	4,5	5	9,5	4,5	10	5	4,5	9	6,7
MM											
	3,5	5,5	4	3,5	5,5	4	6	3	4	5,5	4,5

А.Д. Мурадов, А.М. Есенгазиев, Г.С. Суюндыкова Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті г.Алматы, Казахстан; aza.007.91@mail.ru

ҚАБЫҚША Т**Н**ЗУШІ ҚАБАТ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ АЛЫНҒАН ПОЛИИМИДТЫҢ ФОТОСЕЗІМТАЛ ҚІ**Б**РЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ

Аннотация. Бұл жұмыс жұқа аморфты күміс қабықшаларының бетін эксперименталды зерттелінуіне сүйенген. Күміс қабықшасының топографиялық бейнесі кедір-бұдырлы рельефпен сипатталады. Жалпы айтқанда бет морфологиясы кластерлік құрылымды кәрсетеді. Кластердің кәрінетін мәлшері қабықшаның қалыңдығымен сәйкес, кластердің формасы изометриялық емес,беттік шегі байқалмаған, домалақ пішіндес.Дегенментығыз жинақталуына байланысты кәп жағдайларда полиэдрлік формаға ие. Күміс қабықшалардың кластерлері бір-бірінен анық ажыратылады және кластерлердің статикалық әлшемдері бірбірінен алшақ емес.Қабықша металдануының барлық үш типіне сәйкес, сәулелендіру дозасының әсуі, электр кедергісінің де айтарлықтай әсуіне алып келетінің кәрсетті.

Маңызды с**ә**здер: қабықша, аморфтыкүміс, ұнтақ, нанобәлшектер, морфология, электр кедергісі.

А.Д. Мурадов, А.М. Есенгазиев, Г.С. Суюндыкова Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан; aza.007.91@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛИИМИДА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Аннотация. В данной работе показаны экспериментальные исследования поверхности серебра. Топографические изображения поверхности тонких аморфных пленок металлических пленок характеризуются шероховатым рельефом, в целом морфология соответствует кластерной (блочной) структуре. Видимые размеры кластеров, как правило, коррелируют с толщиной пленок, сами кластеры имеют неизометрическую округлую форму, поверхностная огранка не просматривается, хотя в последствие, вероятно, плотной упаковки нередко они принимают форму полиэдров. Кластеры серебряных пленок визуализируется достаточно четко, кластеры хорошо разрешаются по отдельности, что проявляется ввиде трещиноватости пленки, при этом статистический разброс размеров относительно невелик. Полученные результаты показывают, что с возрастанием дозы облучения для всех трех типов металлизации образцов наблюдается существенный рост электросопротивления.

Ключевые слова: пленка, аморфные пленки серебра, порошок, наночастицы, электрическое сопротивление.

A.D. Muradov, A.M. Esengazyev, G.S. Suiundykova Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan; aza.007.91@mail.ru

RESEARCH OF PHOTOSENSITIVE STRUCTURE OF THE POLYIMIDE OF FOREIGN AFFAIRS RECEIVED ON THE BASIS OF A FILM-FORMING COVERING

Abstract: Experimental researches of surface thin amorphous films of silver have shown in this work. Topographic image of the surface of metal films are characterized by rough terrain, in general morphology corresponds to a cluster (block) structure. Visible sizes of clusters tend to correlate with the thickness of the films, the clusters themselves are not isometric rounded shape cut surface is not visible, although subsequently probably close packing they often take the form of polyhedra. Clusters of silver films rendered quite clearly, clusters are well resolved individually, which is manifested in the form of fracture of the film, and the statistical distribution of sizes is relatively small.

Key words: film, amorphous film of silver powder, nanoparticles, electric resistance.